公司代码:688627 公司简称:精智达

深圳精智达技术股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中相关内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.24元(含税)。截止2026年4月9日,公司总股本94,011,754股,扣除公司回购专用账户中股份总数为211,477股后的股本93,800,277股为基数,以此计算拟派发现金红利总额为人民币21,011,262.05元(含税)。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.12%。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

上述利润分配方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	精智达	688627	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭娟	黄琳惠
联系地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园D栋1楼东	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园D栋1楼东
电话	0755-21058357	0755-21058357
传真	/	/
电子信箱	jzd@seichitech.com	jzd@seichitech.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

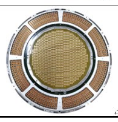
公司作为专注于半导体测试检测设备及系统解决方案的创新企业,以实现关键设备自主可控为核心目标,着力构建系统化全站点服务能力。秉持“不断提供最优质的产品和服务、坚持技术创新、创造价值以助力社会进步”的企业使命,公司聚焦技术创新,持续深耕半导体行业需求。

1、半导体测试解决方案

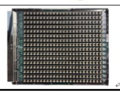
公司的半导体测试方案主要面向DRAM等存储器领域,覆盖晶圆制造环节的裸片电性能与功能测试,以及封装测试环节的芯片颗粒电参数测试、功能测试、老化及修复,确保产品符合设计规范。此外,公司还推出了算力芯片测试设备,旨在提升SoC芯片的测试效率与精度、降低测试成本,进一步丰富产品布局。

公司的半导体存储器件测试解决方案涵盖晶圆测试设备、老化测试及修复设备、FT测试机、MEMS探针卡及其他测试配件。主要产品如下:

(1)存储器晶圆测试设备

主要产品名称	产品简介	产品图示
晶圆测试机	针对DRAM晶圆在封装前的功能指标测试、电学参数测试及缺陷修复需求,提供专用的晶圆测试设备解决方案	
MEMS探针卡	主要用于晶圆测试时实现测试机与被测芯片的电气联接,通过传输信号对芯片参数进行测试	

(2)存储器老化测试及修复设备

主要产品名称	产品简介	产品图示
老化测试及修复设备	对封装后的芯片颗粒进行高低温与大电流环境下的老化测试,在测试中对颗粒内部缺陷进行修复	
老化测试及修复治具板	主要用于连接封装后DRAM芯片和老化测试BI设备,是老化测试及修复设备中重要的部件	

(3)存储器封装测试设备

主要产品名称	产品简介	产品图示
DRAM FT测试机	对封装后的DRAM颗粒进行功能与高速接口与功能测试	
DRAM通用测试验证系统(UDS)	面向DRAM设计及制造企业研发的紧凑型便携式可移动测试系统	

2、新型显示器件检测解决方案

公司的新型显示器件检测解决方案主要用于AMOLED、TFT-LCD、微显示等新型显示器件的Cell与Module制程的光学特性、显示缺陷、电学特性等各种功能检测及校准修复,用于产品缺陷检测、产品等级判定与分类,对部分产品缺陷进行校准、修复及复判,从而提升产品良率、降低生产损耗,并为相关工序的工艺提升提供数据支撑。

公司的新型显示器件检测解决方案主要包括光学检测及校正修复系统、老化系统、信号发生器及检测系统配件等,具体情况如下:

(1)光学检测及校正修复系统

主要产品名称	产品简介	产品图示
Wafer AOI设备	对硅基Micro LED/OLED点亮后的光、电性能进行拍照分析,应用于Wafer段点灯工序的功能与缺陷检测,适用XR检测	
Cell光学检测设备	主要用于新型显示器件Cell制程的自动对位压接、白平衡调节、点灯/外观缺陷AOI检测、自动分类分级下料等工序	
Module光学检测设备	主要用于新型显示器件Module制程的Gamma调节、AOI检查、外观检查等工序	
Gamma调节设备	主要用于新型显示器件Module制程的Gamma调节	
Micro LED/OLED模组AOI检测设备	主要用于封装后Micro LED/OLED模组的Mura补偿,及点灯与外观缺陷AOI检测	

(2)老化系统

主要产品名称	产品简介	产品图示
Cell老化设备	主要用于新型显示器件Cell制备后的点亮老化	
Module老化设备	主要用于新型显示器件Module开发设计过程中的例行试验,以及量产过程中的检验	
Micro LED老化设备	主要用于新型显示器件Module在点亮状态下的品质验证与老化测试,提供温度环境以确认可靠性,适用XR检测	
Micro OLED老化设备	用于新型显示器件Module开发设计及量产中、产品点亮状态下的品质验证和老化测试,提供温度运行环境以确认产品的品质可靠性,适用XR检测	

(3)信号发生器及光学仪器

主要产品名称	产品简介	产品图示
Cell信号发生器	主要用于新型显示器件Cell制程的检测信号及电源供给,可用于点灯检测及老化等工序	
Module信号发生器	主要用于新型显示器件Module制程,可用于点灯检测、Gamma调节、Mura补偿及老化等工序	
老化测试信号发生器	主要用于AR显示模组产品高温/常温老化测试等应用场景	
微显示信号发生器	主要用于AR显示模组产品检测等应用场景,提供多路高精度电源及MIPI、LVDS、QSPI等信号	
成像式亮度计	主要用于显示器件、Micro-LED、Mini-LED、AR/VR近眼显示、车载显示、背光模组及光学模组等领域的亮度均匀性和缺陷检测	
成像式色度计	主要用于显示面板、Micro-LED、OLED、AR/VR近眼显示、车载显示及背光模组等领域,用于评估上述产品的亮度、色度均匀性及显示品质检测	

(4)检测系统配件

检测系统配件主要包括检测治具、检测耗材及其他辅助设备等。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司通过向下游半导体存储和新型显示制造厂商销售设备、配件或提供服务实现收入和利润。报告期内,公司主营业务收入来源于设备及配件的销售等,其他业务收入来源于设备维护服务等。

2、研发模式

公司严格践行“量产一代、在研一代、预研一代”的阶梯式可持续研发节奏,构建产业化落地与技术迭代双向赋能的良性循环,从而保障业务的持续拓展,并为长期发展奠定坚实基础。公司研发团队密切关注及学习半导体存储器件及新型显示器件行业的先进技术,及时把握下游行业发展动向和产品革新信息,设定前瞻式研发计划,针对潜在目标市场提前进行技术储备。同时,公司研发团队基于不同的项目特点,进行需求细化和技术分析,结合公司已有的研发成果,组织研发力量进行技术开发及产品交付,在项目完成后将技术成果模块化、固定化,便于后续其他项目与产品研发重复使用与调取。通过市场与研发的衔接,公司的研发工作持续输出,确保在技术上的可行性和经济收益上的稳定性,有效提高研发效率,降低研发风险。

3、采购模式

公司主要根据产品销售订单设计参数并出具物料清单,制定原材料采购计划。对于部分交货期较长的核心原材料,公司根据市场情况进行适量备货,以及时响应客户需求。公司综合考虑产品质量、采购价格、订单交期、售后服务及合作关系的稳定性等因素选择供应商,已与主要供应商建立了长期且稳定的合作关系。

4、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式,根据客户对所需产品的性能、规格、配置的要求进行定制化生产。公司产品生产严格遵循研发定型的硬件图纸与工艺说明,经过物料采购、硬件装配、软件安装、系统调试等一系列生产流程控制和严格的质量检验,最终交付客户合格的产品。

5、销售模式

公司采用直销模式,产品主要向下游客户直接销售,通过商业谈判或招投标方式获取订单。公司与产业下游主流厂商建立了稳定的合作关系,深入了解客户需求,不断完善产品和服务,增加市场份额和品牌知名度。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

半导体产业是信息技术产业及现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,其发展水平是衡量国家或地区综合竞争力的重要标志。半导体设备作为半导体产业的核心支撑与关键驱动力,近年来持续获得国家层面政策的密集扶持,行业已进入关键核心技术攻关与产业化落地的战略突破阶段。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》将“加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力”作为核心任务,明确强调在集成电路等重点领域推动关键核心技术取得决定性突破,并强化企业科技创新主体地位。具体政策如下:

序号	时间	发文部门	法律法规及政策	主要内容
1	2026年3月	中共中央	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节,采取超常规措施,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
2	2025年8月	工信部、市监总局	《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》	坚定不移推动“国货国用”,持续推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链……强化计算等领域芯片、零部件、整机系统等研发应用和配套适配。
3	2024年7月	中国共产党二十届三中全会	《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制,全链条推进技术攻关、成果应用。
4	2023年2月	工信部等七部门	《智能检测装备产业发展行动计划(2023—2025年)》	供给能力提升重点方向:关于电子行业方面,突破电性能测试系统、高精度探针台等。
5	2023年12月	国家发改委	《产业结构调整指导目录(2024年本)》	将球栅阵列封装(BGA)、插针网格阵列封装(PGA)、芯片规模封装(CSP)、多芯片封装(MCM)、栅格阵列封装(LGA)、系统级封装(SIP)、倒装封装(FC)、晶圆级封装(WLP)、传感器封装(MEMS)、2.5D、3D等一种或多种技术集成的先进封装与测试,集成电路装备及关键零部件制造,Mini/Micro LED显示等新型显示器件生产及专用设备列为鼓励类产业。
6	2021年12月	财政部等五部门	《国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2021年修订)》	集成电路自动化测试及分选设备属于国家支持发展的重大技术装备和产品。

综上,在政策层面,国家“十五五”规划顶层设计与细分领域专项行动方案相互衔接、协同发力,共同构建了覆盖全维度、多层次的政策支撑体系。该政策体系不仅为我国半导体测试检测设备行业高质量发展筑牢了坚实基础,更有效推动行业加速实现从“技术追赶”向“自主创新”的战略转型,为行业内企业发展提供了明确的政策指引和有力的政策保障。

政策引导与市场需求的双重驱动下,我国半导体测试设备行业正处于技术迭代加速、市场规模持续扩容的关键发展阶段,行业整体呈现稳步向好的发展态势。但从行业竞争格局来看,高端市场仍由国际龙头企业主导,以核心设备测试机为例,2024年国外前两大厂商在中国大陆市场的合计占有率高达80%,高端领域国产化率处于较低水平。随着本土企业在核心技术领域的持续突破(如部分测试设备已实现从0到1的验证与导入),本土半导体测试检测设备厂商在高端市场具备巨大的突破潜力,行业正迎来关键窗口期。

与此同时,下游应用场景的持续爆发为行业发展创造了全新的增长极。在人工智能与新型人机交互浪潮的驱动下,Micro LED等微显示技术加速落地应用,行业产业化进程不断推进。XR作为下一代信息交互的核心载体,其终端市场呈现快速增长态势,据CINNO Research相关数据,2025年国内消费级AI/AR市场销量同比激增109%。在此发展进程中,XR检测设备作为提升相关产品良率、降低制造成本的核心支撑,其市场需求有望迎来快速放量,成为半导体测试检测设备行业重要的新增量,为行业内企业带来广阔的市场发展空间。

(2)行业基本特点

半导体测试检测设备行业具有技术壁垒高、资金投入大、与下游产业链协同性强的显著特征。随着芯片技术加速迭代与应用场景持续拓展,行业竞争逻辑深刻重塑,主要呈现以下特点:

一是技术迭代与产品升级强绑定。半导体测试设备的技术迭代速度与芯片制程升级、架构创新高度同步,随着芯片向先进制程演进,功能日趋复杂,应用方面向AI芯片、车规芯片等复杂场景延伸,对测试功能和指标不断提出新的要求,因此测试设备需要不断升级,研发工作的介入点大幅前移至前期工程验证阶段(即“左移”),企业需持续加大研发投入,以快速匹配新型芯片的测试需求。同时,随着AMOLED、XR显示、Micro LED等显示技术的快速迭代,检测设备需同步升级检测精度、响应速度与多场景适配能力,适配不同显示面板的分辨率、像素尺寸、刷新率、亮度等核心参数,并紧跟新型显示技术推广节奏,快速完成产品迭代,满足下游产线的良率管控与性能检测需求。

二是资金密集型与技术密集型属性显著。本行业为知识和技术密集型行业,产品研发涉及电子电路设计、精密光学、精密机械设计与自动化控制,以及软件算法等多学科、多领域知识的综合运用,具有较高的技术和客户验证壁垒。国外龙头设备厂商通过长期大规模的研发投入,以此保持产品技术优势并巩固行业领先地位。本行业亦具有显著的资金密集型特征,技术研发、生产运营及配套服务均需要大量且持续的资本投入。

三是产业链协同性强,深度绑定下游客户。半导体测试设备与下游客户深度协同,产业链协同深度直接决定客户黏性与市场竞争力。AMOLED、XR检测设备亦然,需在产线建设初期嵌入关键工艺节点,与工艺设备协同推动良率爬坡与产能释放,是产线闭环控制的核心环节。

四是需求分化明显,高端场景驱动增长。当前AI芯片、车规芯片、HBM存储芯片等高端场景,对测试设备的功能、精度、速度、最大并测数以及可靠性均提出极高要求,需求爆发式增长;随着XR终端加速渗透,以Micro LED为代表的微显示技术受到广泛关注,检测设备作为提升良率、降本增效的关键支撑,需求有望逐步放量。应用场景的迭代升级,仍是行业需求增长的核心驱动力。

(3)主要技术门槛

半导体测试检测设备的技术门槛贯穿研发、生产、适配全环节,其核心壁垒可归纳为以下主要维度,构成行业准入的核心障碍,也是本土企业实现技术突破的关键瓶颈。

第一,高速测试技术壁垒。随着HBM、算力芯片及先进封装等新兴技术的快速发展,市场对半导体测试设备的测试速率提出了更高要求,高速化已成为行业核心演进方向,也是重要的技术壁垒。AI技术对高性能算力、高密度存储的极致诉求,叠加其在智能驾驶、云计算、边缘计算等新兴场景的广泛应用落地,持续驱动半导体产业链上下游加速技术迭代、产品升级与制程革新,以算力芯片、HBM为代表的高端芯片测试需求显著提升。这类高端芯片的性能验证,对测试设备的信号传输速率、同步精度等核心指标提出严苛标准,在前沿技术不断迭代的同时,也为半导体测试设备厂商的技术升级带来巨大挑战,进一步强化了高速测试技术的壁垒属性。

第二,核心零部件制备壁垒。半导体测试设备的核心零部件包括高精度传感器、专用ASIC芯片、高速信号处理器、精密连接器等。其中,专用ASIC芯片需满足高带宽、低延迟的测试需求,是测试设备的核心部件,其设计涉及数模混合信号处理,技术复杂度远高于通用芯片。核心零部件的制备技术高度集中于少数海外企业,本土企业面临供应链安全风险,零部件进口依赖度较高。同时,核心零部件的稳定性直接决定测试设备的整体可靠性,进一步抬升了生产端的技术门槛。此外,在晶圆测试环节,探针卡(尤其是MEMS探针卡)作为连接晶圆与测试机的关键部件,其在高低温环境下的形变控制能力与微小信号传输性能,同样是重要的技术壁垒。

第三,客户认证与海外头部友商生态壁垒。半导体测试设备直接影响芯片成品的质量与良率,下游芯片企业对设备的可靠性、稳定性要求极为严格。设备投入产线后需经过长期、大规模的量产验证,方能获得客户认可。这一验证周期不仅关乎客户信任的建立,更是对设备极限性能的检验:设备必须在海量芯片的测试过程中保持极低的误判率,任何偏差均可能显著增加半导体厂商的测试成本。海外头部企业凭借长期的技术积累与客户资源,已形成成熟的验证体系与客户信任,构建了从研发验证到量产应用的完整生态闭环。本土企业即便在技术上实现突破,仍需经历较长的客户验证周期,短期内难以大规模切入高端市场。

第四,光学检测技术壁垒。随着显示技术与先进封装的融合发展,OLED、Micro LED及XR微显示器件对光学检测提出更高要求。光学检测设备需集成高分辨率成像系统、光谱分析模块及精密运动控制平台,以完成亚微米级缺陷检测、亮度色度测量计算以及Mura判定与修复。其技术难点主要体现在:显示器件本身发光效果与效率变化的问题、光学串扰的问题、高色纯显示器件的色彩还原与测量问题,以及高NA光学系统姿态调整的问题。光学检测算法需结合运动控制、环境控制等多个工程领域,协同完成显示器件的精密量测与检测。目前,高端光学检测核心部件(如高灵敏度相机、高NA光学系)及算法软件仍由国外企业占据主导地位。能够系统掌握上述关键技术、实现核心部件与算法自主可控的企业,将在高端光学检测领域构筑起显著的技术壁垒与竞争优势。

总体来看,上述技术壁垒共同构成了半导体测试检测设备行业的高准入门槛。本土企业需在高速测试技术、核心零部件突破、客户验证体系建设以及前沿光学检测技术等方面协同发力,方能逐步缩小与海外龙头的差距,提升在高端市场的竞争力。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在人工智能加速产业创新、半导体产业国内自主突破的时代背景下,公司以打造半导体测试检测设备平台型企业为战略目标,以测试检测技术为核心入口、以人工智能为关键驱动力,持续深化技术创新与产业应用融合,不断完善多场景系统化解决方案能力,稳步提升在产业链中的战略地位与行业影响力。

依托在半导体存储测试领域多年深耕与自主创新,公司已形成覆盖半导体存储器测试领域关键设备与配套治具的完整产品线,主要包括晶圆测试设备、老化测试及修复设备、FT测试机、MEMS探针卡及其他测试配件,是国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商。相关产品已在多条产线实现对国外供应商的替代,成为客户相关产品主要供应商,助力关键生产环节自主突破。

公司坚持自主研发,核心技术自主突破,在海量通道高速信号连接、高精度时序信号生成及驱动、DRAM测试及修复算法、宽温区高均匀度老化控制等关键领域形成深厚技术积累。公司在高速芯片测试领域取得关键突破,报告期内,公司向客户交付首台自主研发的9 Gbps高速FT测试机,同时稳步推进18 Gbps高速FT测试机项目。目前半导体存储测试设备核心产品线多项关键性能指标已达国际先进水平,为公司参与高端测试设备市场竞争奠定了坚实的技术基础与核心能力。

公司与国内头部半导体存储厂商、新型显示制造厂商建立长期稳定的深度合作关系,核心产品规模化应用于国内头部厂商生产线。其中老化测试修复设备、探针卡等产品成功实现进口替代,成为国内头部半导体存储厂商主力供应商,报告期内市场占有率持续提升。

在AI加速产业创新、半导体产业国内自主可控的时代背景下,公司以打造半导体测试设备平台型企业为战略目标,以测试检测技术为核心入口、以AI为关键驱动力,持续深化技术创新与产业应用融合,将不断完善多场景系统化解决方案能力,稳步提升在产业链中的战略地位与行业影响力。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,以人工智能为核心的新一代信息技术正深刻重塑全球半导体产业格局。AI生态的持续完善驱动算力需求稳步攀升,叠加HPC、XR等下游应用对芯片性能提出的更高要求,推动半导体产业在算力供给、存储带宽、显示精度等核心维度发生结构性变革。当前,半导体产业正逐步进入由AI算力基础设施、先进逻辑芯片、先进封装技术与高端存储器件共同驱动的新一轮上行周期。

半导体产业上行周期的发展态势,直接带动了半导体测试设备销售的增长。据SEMI统计,2025年全球半导体测试设备销售额预计同比增长48.1%,且2026年至2027年将延续增长态势。半导体测试设备行业龙头企业基于对全球半导体测试设备行业及下游核心需求的深度研判,表示尽管市场存在对AI投资节奏波动的担忧,但领先AI芯片、定制ASIC及高端存储器件的投资仍将持续推进。此类器件的研发生产对测试设备的高端化、精细化需求显著,将持续拉动半导体测试设备市场需求。同时,随着芯片器件复杂度提升、芯片单价上涨,下游客户为保障产品良率、性能及质量,将增加测试时间、优化测试流程、丰富测试内容。半导体测试环节已不再单纯属于成本项,而是逐步成为提升产品良率与质量的“价值创造环节”,进一步凸显半导体测试设备的核心价值。

旺盛的市场需求直接传导至供给端,驱动全球晶圆厂产能加速扩张。与销售数据相呼应,全球晶圆厂产能扩张持续提速。据SEMI预测,到2030年,全球晶圆产能总量将从2020年的2510万片/月提升至4450万片/月,其中中国产能总量将从2020年的490万片/月增至1410万片/月,市场份额从20%提升至32%。随着晶圆产能持续增长,晶圆厂扩建步伐同步加快,预计2028年全球新建晶圆厂中,中国将独占47座,占亚洲新增产能的一半以上,成为全球产能扩张的核心区域。

产能扩张伴随而来的是供需格局的深刻重塑,传统周期波动已被结构性紧平衡取代。同时,产业价格格局与周期特征亦发生显著变化。受AI服务器对HBM、服务器DRAM及企业级SSD需求快速提升的影响,全球存储产业已由传统周期波动逐步演化为“AI需求驱动下的结构性紧平衡”格局。TrendForce数据显示,2026年一季度常规DRAM及NAND Flash价格均出现大幅上行,行业供需关系显著收紧。与此同时,全球主要存储厂商正将更多先进制程和新增产能优先投向HBM及高端服务器存储产品,并纷纷公布相应扩产计划,进一步强化结构性紧平衡的发展态势。这一格局变化直接利好具备高端测试能力的设备厂商。

从技术迭代角度看,AI对高性能算力与高密度存力的极致诉求,推动算力芯片、高带宽存储(HBM)等高端芯片需求激增。此类芯片功能复杂、数据吞吐量大,导致测试环节面临两大核心难题:一是测试内容趋于复杂,需应对庞大数据流与多维度算法验证;二是测试速度必须提升,以匹配HBM、先进封装等新兴技术的迭代节奏。上述供需矛盾直接转化为高端测试设备的刚性市场需求。

与此同时,随着摩尔定律逼近物理极限,2.5D/3D封装、Chiplet等先进封装成为延续性能提升的关键路径。芯片结构从平面走向立体,对测试设备的信号精度、多通道协同能力提出严苛要求。以HBM为例,其高密度垂直堆叠结构不仅驱动测试设备向更高精度、更强并行能力迭代,更从根本上改变测试逻辑——测试模式从“抽样测试”转向“全深度测试”,测试时间大幅延长,为存储测试设备带来技术升级与测试密度提升的双重结构性增长机会。

为应对上述挑战,半导体测试设备自身正经历深刻的技术迭代,主要体现在测试速度、平台化集成与智能化三大核心方向的加速演进。测试速度方面,面向AI算力芯片、高端存储芯片、先进SoC芯片等产品,测试设备正加速向高通道数、高信号速率、高并行度方向演进,以满足高速传输、低时延、高可靠性的严苛测试要求。平台化集成方面,行业主流技术路径已转向通用化、模块化软硬件架构,通过同一平台兼容多品类芯片测试,有效降低客户产线改造成本、提升测试适配效率。智能化方面,AI算法与大数据分析正深度融入测试流程,推动测试设备从“被动检测”向“主动预判”升级,通过实时数据分析实现测试参数动态优化与良率预警,显著提升测试效率与产品良率。上述技术方向的深度演进,正成为半导体测试设备构筑核心竞争力的关键支撑。

在人机交互领域,XR等新兴设备的崛起为微显示技术带来产业化提速机遇。微显示技术向高分辨率、高对比度方向持续演进,要求相关企业将AI算法与数据分析深度融入检测方案。XR及智能眼镜的快速发展正驱动Micro OLED/LED加速产业化,据IDC 2024年发布的数据预测,2024年至2029年全球AR/VR市场规模复合增长率达21.1%,其中中国市场以41.4%的增速成为全球增长极,为国产微显示检测设备厂商创造显著增量空间。

综上,本轮半导体测试检测设备市场增长的核心驱动力,源于下游应用对芯片性能的极致追求与芯片制造工艺向物理极限的持续探索。两者共同作用,使测试设备的精度、速度与并行处理能力成为制约芯片量产的关键瓶颈,推动市场规模持续扩张。在此背景下,能够紧跟技术迭代、在精度与速度等核心指标上实现突破的本土厂商,有望在国产化替代进程加速中充分受益。公司所处的半导体测试设备环节,兼具“新增产能导入”与“测试复杂度提升”双重驱动,未来在存储、算力、先进封装及国产替代等多重趋势叠加下,预计将迎来持续扩大的市场空间和发展机遇。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,345,441,630.53	2,030,354,809.18	15.52	1,996,487,508.09
归属于上市公司股东的净资产	1,723,144,422.70	1,721,973,056.36	0.07	1,719,227,487.47
营业收入	1,128,061,120.07	803,129,707.64	40.46	648,563,325.45
利润总额	67,382,310.27	73,542,244.99	-8.38	129,543,657.61
归属于上市公司股东的净利润	65,421,196.82	80,160,244.51	-18.39	115,684,848.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,878,970.42	68,855,656.78	-14.49	84,346,700.88
经营活动产生的现金流量净额	105,333,229.97	14,564,741.84	623.21	-13,548,051.46
加权平均净资产收益率(%)	3.80	4.66	减少0.86个百分点	10.71
基本每股收益(元/股)	0.7024	0.8562	-17.96	1.4406
稀释每股收益(元/股)	0.7015	0.8562	-18.07	1.4406
研发投入占营业收入的比例(%)	16.23	13.66	增加2.57个百分点	11.08

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	152,111,547.64	291,517,964.90	309,410,485.42	375,021,122.11
归属于上市公司股东的净利润	-16,215,794.47	46,802,768.72	10,882,103.72	23,952,118.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,029,837.37	45,412,077.32	10,382,022.82	21,114,707.65
经营活动产生的现金流量净额	-13,562,138.68	-53,407,392.20	43,072,759.09	129,230,001.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,788
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,495
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张滨	0	17,474,715	18.59	17,474,715	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,904,344	3,451,058	3.67	0	无	0	境外法人
中信银行股份有限公司—永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	2,600,000	2,600,000	2.77	0	无	0	其他
深圳市萃通投资合伙企业(有限合伙)	0	2,410,040	2.56	0	无	0	其他
深圳国中创业投资管理有限公司—深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-3,176,547	2,054,355	2.19	0	无	0	其他
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)	-3,046,720	2,000,000	2.13	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	1,877,092	1,877,092	2.00	0	无	0	其他
深圳源创力清源创业投资合伙企业(有限合伙)	-276,623	1,813,246	1.93	0	无	0	其他
深圳市丰利莱投资合伙企业(有限合伙)	0	1,775,311	1.89	0	无	0	其他
深圳市睿通达投资合伙企业(有限合伙)	0	1,625,000	1.73	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				深圳萃通、深圳丰利莱为公司员工持股平台,张滨担任深圳萃通、深圳丰利莱执行事务合伙人,系一致行动人。源创力清源、常州清源、新麟二期的执行事务合伙人及管理人同受深圳清源时代投资管理控股有限公司控制,互为一致行动人			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用			

存托凭证持有人情况

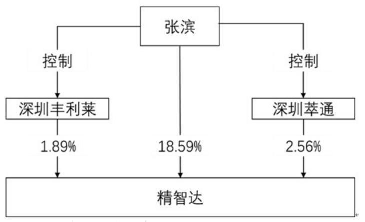
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

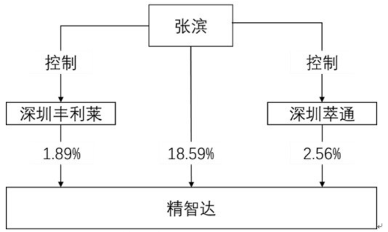
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入112,806.11万元,同比增长40.46%;归属于上市公司股东的净利润6,542.12万元,同比下降18.39%。截至报告期末,公司资产总额234,544.16万元,归属于上市公司股东的净资产172,314.44万元,财务状况稳健。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2026-032

深圳精智达技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”或“精智达”)于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑目前募集资金投资项目的实施进度等因素,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2028年2月。保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。上述事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1170号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,350.2939万股,每股发行价格为人民币46.77元,募集资金总额为人民币109,923.25万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币11,266.79万元后,募集资金净额为人民币98,656.46万元。

上述募集资金已于2023年7月13日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2026年2月28日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后拟使用募集资金金额	已累计投入募集资金总额	募集资金投入进度(%)
1	新一代显示器件检测设备研发项目	19,800.00	19,800.00	8,647.37	43.67
2	新一代半导体存储器件测试设备研发项目	16,200.00	16,200.00	16,266.27	100.42
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
4	超募资金用于先进封装设备研发项目	不适用	29,960.74	10,704.20	35.73
5	超募资金用于补充流动资金	不适用	8,695.72	10,639.38	122.35
合计		60,000.00	98,656.46	70,257.22	71.21

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因延期原因

(一)本次部分募集资金投资项目延期的基本情况

在结合考虑当前宏观经济环境、新型显示行业发展状况及公司实际投资进度和建设情况等背景下,经过综合分析与审慎评估,公司决定在项目实施主体、募集资金投资用途及规模均不发生变更的情况下,将“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态时间延期至2028年2月。

单位:人民币万元

	本次调整前			本次调整后		
序号	项目名称	募集资金投资额	项目达到预定可使用状态日期	项目名称	募集资金投资额	项目达到预定可使用状态日期
1	新一代显示器件检测设备研发项目	19,800.00	2026年8月	新一代显示器件检测设备研发项目	19,800.00	2028年2月

(二)本次部分募集资金投资项目延期的具体原因

自募集资金到位以来,公司稳步推进“新一代显示器件检测设备研发项目”建设,审慎规划募集资金的使用。鉴于AMOLED、大尺寸超高清等新型显示技术的整体商业化进程及发展节奏慢于行业预期,且行业内蒸镀、ViP、印刷OLED等多元技术路径仍处于并行发展期,尚未完全收敛等因素的综合影响,为保障募投项目的投资有效性,公司基于当下所处的市场环境和技术发展趋势,对项目实施节奏进行了适当调整,致使相应的建设进度周期较原计划有所延长。

为维护公司及全体股东利益,充分考虑募投项目建设周期与资金使用情况,经审慎的研究论证,公司决定将“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态时间调整至2028年2月。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态的时间延期,延期至2028年2月。保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

本次新一代显示器件检测设备研发项目延期事项已经公司董事会审议通过,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,本次部分募集资金投资项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2026-035

深圳精智达技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月19日 15点00分

召开地点:深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》	√
4	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订公司部分内部管理制度的议案》	√
5.01	《深圳精智达技术股份有限公司董事薪酬管理制度》	√
5.02	《股东会议事规则》	√
5.03	《董事会议事规则》	√
5.04	《关联交易决策制度》	√
5.05	《对外担保管理制度》	√
5.06	《募集资金管理办法》	√

本次股东会将听取公司《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,相关公告已于2026年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,公司将在2025年年度股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案5.01

应回避表决的关联股东名称:直接持股的董事及高级管理人员,以及与董事关联的股东回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688627	精智达	2026/5/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月15日(9:00-11:00、14:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼公司会议室。

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记,均须在2026年5月15日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函、电子邮件上请注明“股东会”字样。

1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件;

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件等持股证明;

3.法人股东法定代表人/合伙企业股东执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明等持股证明;

4.法人股东法定代表人授权代理人/合伙企业股东执行事务合伙人授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)等持股证明;

注:所有原件均需一份复印件,如通过信函或电子邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼公司会议室

电子邮箱:jzd@seichitech.com

联系电话:0755-21058357

联系人:彭娟

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2026年4月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳精智达技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
3	《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》			
4	《关于修订<公司章程>的议案》			
5.00	《关于修订公司部分内部管理制度的议案》			
5.01	《深圳精智达技术股份有限公司董事薪酬管理制度》			
5.02	《股东会议事规则》			
5.03	《董事会议事规则》			
5.04	《关联交易决策制度》			
5.05	《对外担保管理制度》			
5.06	《募集资金管理办法》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2026-027

深圳精智达技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2026年4月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2026年3月30日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应到董事共9名,实到董事9名。

会议由董事长张滨先生主持,公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定,编制了《2025年年度报告及摘要》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度,公司总经理张滨先生带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度,使公司保持了持续稳定的发展,该报告客观、真实地反映了2025年度经营管理层的主要工作情况。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度,公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定,切实履行董事会职能,认真贯彻执行股东会通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,及时履行信息披露义务,保障公司及全体股东的利益,保证公司健康、稳定的发展。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(四)审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

2025年度,公司董事会审计委员会全体成员能够忠实勤勉地履行工作职责,充分利用专业知识,对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策,有力地促进了公司规范运作。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审查,公司认为大华所在从事公司年度审计服务过程中,尽职尽责,客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见,表现出独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,切实履行了审计机构应尽的职责。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

经核查2025年度独立董事胡亮明先生、邓仰东先生、陈美汐女士及胡殿君先生的任职经历以及签署的相关自查文件,董事会认为,上述人员符合独立董事独立性的相关要求。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-029)。

(九)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状与《公司章程》中关于现金分红政策的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-030)。

(十一)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况,对公司的生产经营无重大影响。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-031)。

(十二)审议通过《2026年度提质增效重回报行动方案》

为积极回报投资者,切实履行公司的责任和义务,公司制定《2026年度提质增效重回报行动方案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

在结合考虑当前宏观经济环境、新型显示行业发展状况及公司实际投资进度和建设情况等背景下,经过综合分析与审慎评估,公司决定在项目实施主体、募集资金投资用途及规模均不发生变更的情况下,将“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态时间延期至2028年2月。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2026-032)。

(十四)审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。

表决情况:全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》(公告编号:2026-033)。

(十五)审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,公司《激励计划》规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已成就,同意为符合归属条件的48名激励对象办理限制性股票归属手续,本次可归属的限制性股票共计11.64万股。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事王磊、曹保桂、崔小兵回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026-034)。

(十六)审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

同意召开公司2025年年度股东会审议相关议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-035)。

(十七)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》(公告编号:2026-028)。

(十八)审议《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025)》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,对部分内部管理制度进行了修订,修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

1.审议《深圳精智达技术股份有限公司董事薪酬管理制度》

表决情况:全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,本议案尚需提请公司股东会审议。

2.审议通过《深圳精智达技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事张滨、王磊、曹保桂、崔小兵回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.审议通过《股东会议事规则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

4.审议通过《董事会议事规则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

5.审议通过《募集资金管理办法》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

6.审议通过《信息披露管理办法》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关联交易决策制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

9.审议通过《对外担保管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2026-033

深圳精智达技术股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员
薪酬与考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:

一、适用范围

公司现任董事、高级管理人员。

二、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事年度津贴标准为人民币8万元(税前),除此之外不再另行支付其他薪酬。

2、非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事,其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬标准或其任职岗位薪酬执行,公司对其不另行发放董事津贴,在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十;未在公司任职的非独立董事不因其担任董事职位额外领取薪酬或津贴。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月9日召开第四届薪酬与考核委员会第四次会议,审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。

(二)董事会的审议情况

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议,审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,本议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2026年4月11日